

LFB215G12SG8A178

生産中

推奨

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
オススメ用途	民生機器,産業機器,医療機器 [GHTF A/B],モバイル機器

包装情報

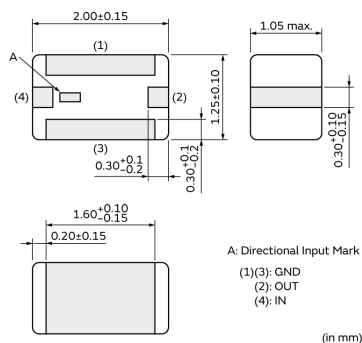
包装コード	仕様	標準梱包数量
-	180mmエンボステーピング	4000

特長

セラミック多層技術を応用して開発された、超小型、超薄型、軽量の共振器型のチップタイプのフィルタです。

1. 超小型、薄型、軽量のバンドパスフィルタ。
2. 無調整で使用可能。
3. リフローによるはんだによるはんだ付けが可能。
4. テーピング寸法を標準としており、チップブレーサーによる自動実装が可能。

外観および形状



お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

LFB215G12SG8A178

スペック

用途	WiFi
公称中心周波数(fo)	5125.00MHz
通過帯域幅	fo±225.00MHz
帯域内挿入損失Ⅰ)	1.50dB max. (at 25℃)
帯域内挿入損失Ⅱ)	1.80dB max. (-40～+85℃)
減衰量(絶対値)Ⅰ)	25.0dB min. at 4200.00MHz
減衰量(絶対値)Ⅱ)	17.0dB min. at 2x(fo±225) MHz
帯域内リップル(max.)	1.2dB
帯域内VSWR(max.)	2.0
特性インピーダンス(公称値)	50Ω
許容電力	500mW
使用温度範囲	-40℃ ～ 85℃
LxW寸法	2.00x1.25mm
T寸法(max.)	1.05mm

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。